

Title (en)
Method of coating metal substrates with a powder primer and a surface coat applied by dipping, powder-primer composition and product obtained.

Title (de)
Verfahren zur Beschichtung eines Metallsubstrats mit Pulvergrundierungsschicht und mittels Tauchen angebrachte Oberflächenbeschichtung, Grundierungszusammensetzung und so erhaltene Materialien.

Title (fr)
Procédé pour revêtir des substrats métalliques à l'aide d'un primaire en poudre et d'un revêtement superficiel appliqué par trempage, compositions de primaire en poudre utilisées et matériaux composites obtenus.

Publication
EP 0367653 A1 19900509 (FR)

Application
EP 89402897 A 19891020

Priority
FR 8814332 A 19881103

Abstract (en)
The present invention relates to the field of coatings of metal substrates applied by dipping. It relates to a method of coating a metal substrate using a surface coat applied by dipping after coating of said substrate with a powder primer. It also relates to powder compositions which can be used as adhesion primer, as well as to composite materials: metal substrates/adhesion primer/surface coat.

Abstract (fr)
La présente invention se situe dans le domaine des revêtements de substrats métalliques appliqués par trempage. Elle concerne un procédé pour revêtir un substrat métallique à l'aide d'un revêtement superficiel appliqué par trempage après enduction dudit substrat avec un primaire en poudre. Elle a également pour objet des compositions en poudre utilisables en tant que primaire d'adhérence, ainsi que les matériaux composites : substrats métalliques/primaire d'adhérence/revêtement superficiel.

IPC 1-7
B05D 1/24; **B05D 1/38**; **B05D 7/14**

IPC 8 full level
B05D 7/14 (2006.01); **B05D 1/24** (2006.01); **B05D 1/38** (2006.01); **B05D 3/10** (2006.01); **B05D 7/00** (2006.01); **B05D 7/24** (2006.01); **B32B 15/08** (2006.01); **B32B 27/34** (2006.01); **B32B 27/38** (2006.01); **C09D 5/00** (2006.01)

CPC (source: EP US)
B05D 1/24 (2013.01 - EP US); **B05D 7/546** (2013.01 - EP US); **B05D 7/587** (2013.01 - EP US); **B05D 2202/10** (2013.01 - EP US); **B05D 2451/00** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)
• [X] FR 2340140 A1 19770902 - CANADA WIRE & CABLE CO LTD [CA]
• [A] US 3502492 A 19700324 - SPILLER LESTER L
• [A] US 2303822 A 19421201 - CHAPMAN FRANK D

Cited by
FR2795004A1; WO2011092444A1; US6506455B1; US7507440B2; WO9737776A1; WO0076677A1; WO2006091440A1

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)
EP 0367653 A1 19900509; **EP 0367653 B1 19930519**; **EP 0367653 B2 20011121**; AT E89496 T1 19930615; AU 4397989 A 19900510; AU 628877 B2 19920924; CA 2002109 A1 19900503; CA 2002109 C 19990216; DE 68906643 D1 19930624; DE 68906643 T2 19931007; DE 68906643 T3 20020529; DK 174338 B1 20021216; DK 546089 A 19900504; DK 546089 D0 19891102; ES 2055133 T3 19940816; ES 2055133 T5 20020501; FI 100661 B 19980130; FI 895222 A0 19891102; FR 2638466 A1 19900504; FR 2638466 B1 19930507; IE 63336 B1 19950419; IE 893536 L 19900503; JP H02258084 A 19901018; JP H0755306 B2 19950614; NO 306956 B1 20000117; NO 894344 D0 19891101; NO 894344 L 19900504; PT 92182 A 19900531; PT 92182 B 20010531; US 5891515 A 19990406

DOCDB simple family (application)
EP 89402897 A 19891020; AT 89402897 T 19891020; AU 4397989 A 19891102; CA 2002109 A 19891102; DE 68906643 T 19891020; DK 546089 A 19891102; ES 89402897 T 19891020; FI 895222 A 19891102; FR 8814332 A 19881103; IE 353689 A 19891102; JP 28728089 A 19891102; NO 894344 A 19891101; PT 9218289 A 19891102; US 46255595 A 19950605